

東京エレクトロン

2008年3月期 中間決算説明会

2007年11月13日

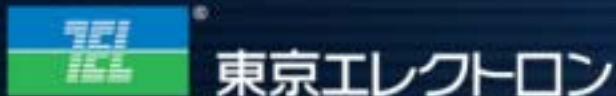
資料取扱い上の注意

将来見通しに関する注意事項

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は円単位で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2008年3月期中間決算概要

経理部 部長 佐伯 幸雄

2007年11月13日

2008年3月期 中間決算(連結) 当中間期の業績

(単位:億円)

	2007/3 前中間期		2008/3 当中間期		対前年増減		2008/3 当中間期 (5/11予想)		差異	
売上高	3,905		4,763		858	22.0%	4,450		313	
SPE	2,839		3,792		953	33.6%	3,540		252	
FPD	525		436		89	-17.1%	400		36	
EC/CN	535		532		2	-0.4%	505		27	
その他	5		2		3	-56.5%	5		2	
売上総利益	1,193	(30.6%)	1,653	(34.7%)	459	38.5%	-	-	-	
販管費	611	(15.7%)	703	(14.8%)	92	15.1%	-	-	-	
営業利益	582	(14.9%)	950	(19.9%)	367	63.1%	770	(17.3%)	180	
経常利益	582	(14.9%)	957	(20.1%)	375	64.6%	790	(17.8%)	167	
税前利益	584	(15.0%)	982	(20.6%)	397	67.9%	790	(17.8%)	192	
当期純利益	372	(9.5%)	624	(13.1%)	252	67.8%	500	(11.2%)	124	

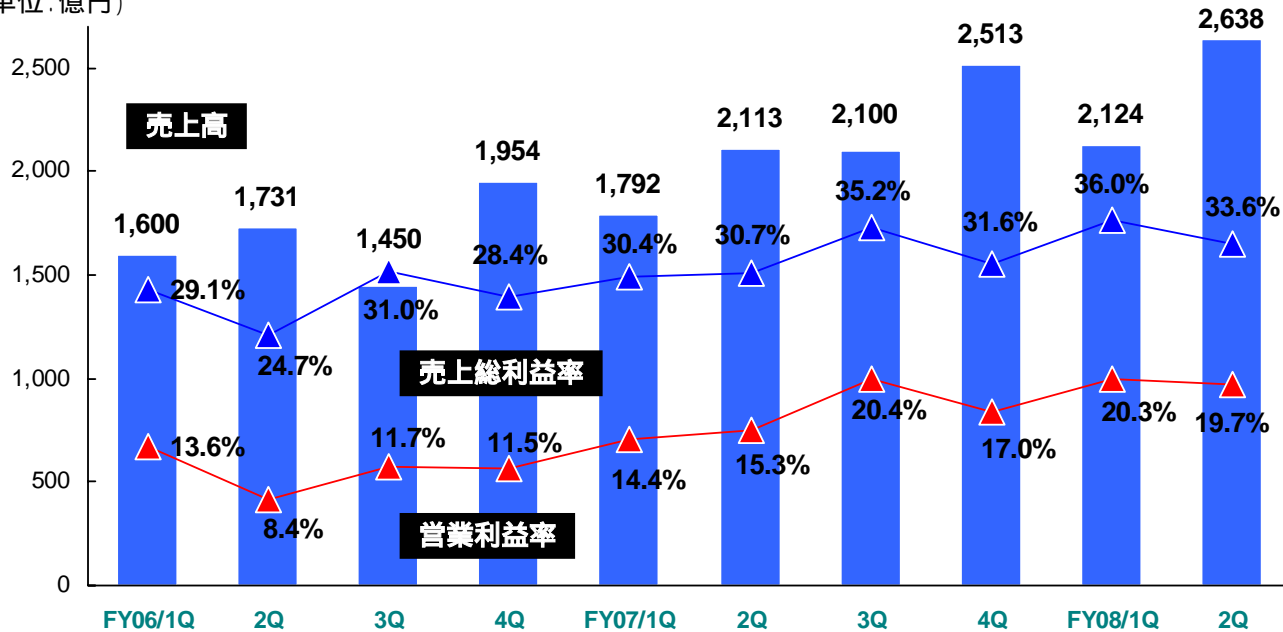
SPE: 半導体製造装置, FPD: FPD製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク



2008年3月期 中間決算(連結)

売上・利益率推移

(単位: 億円)

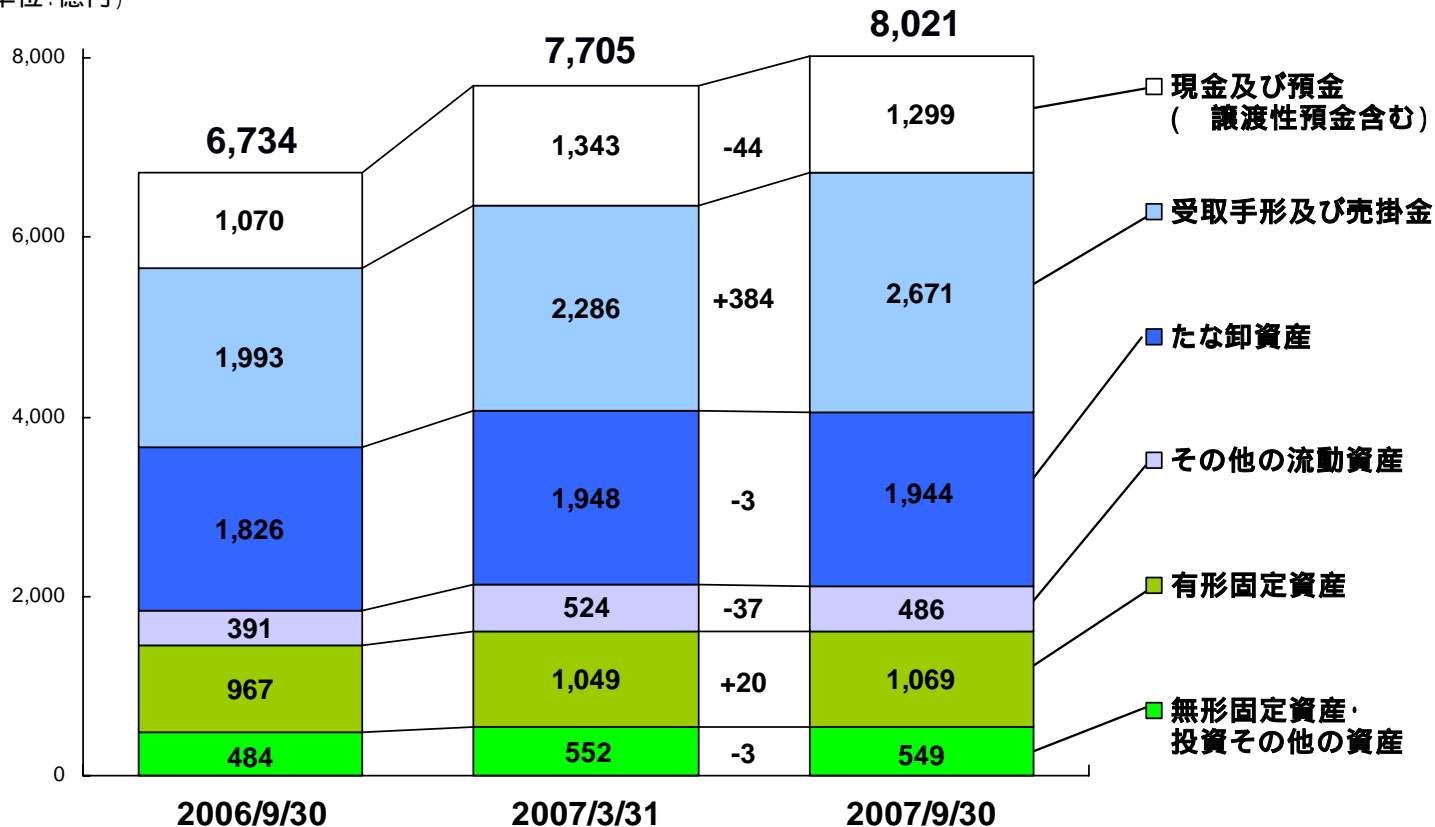


2008年3月期 中間決算(連結)

資産

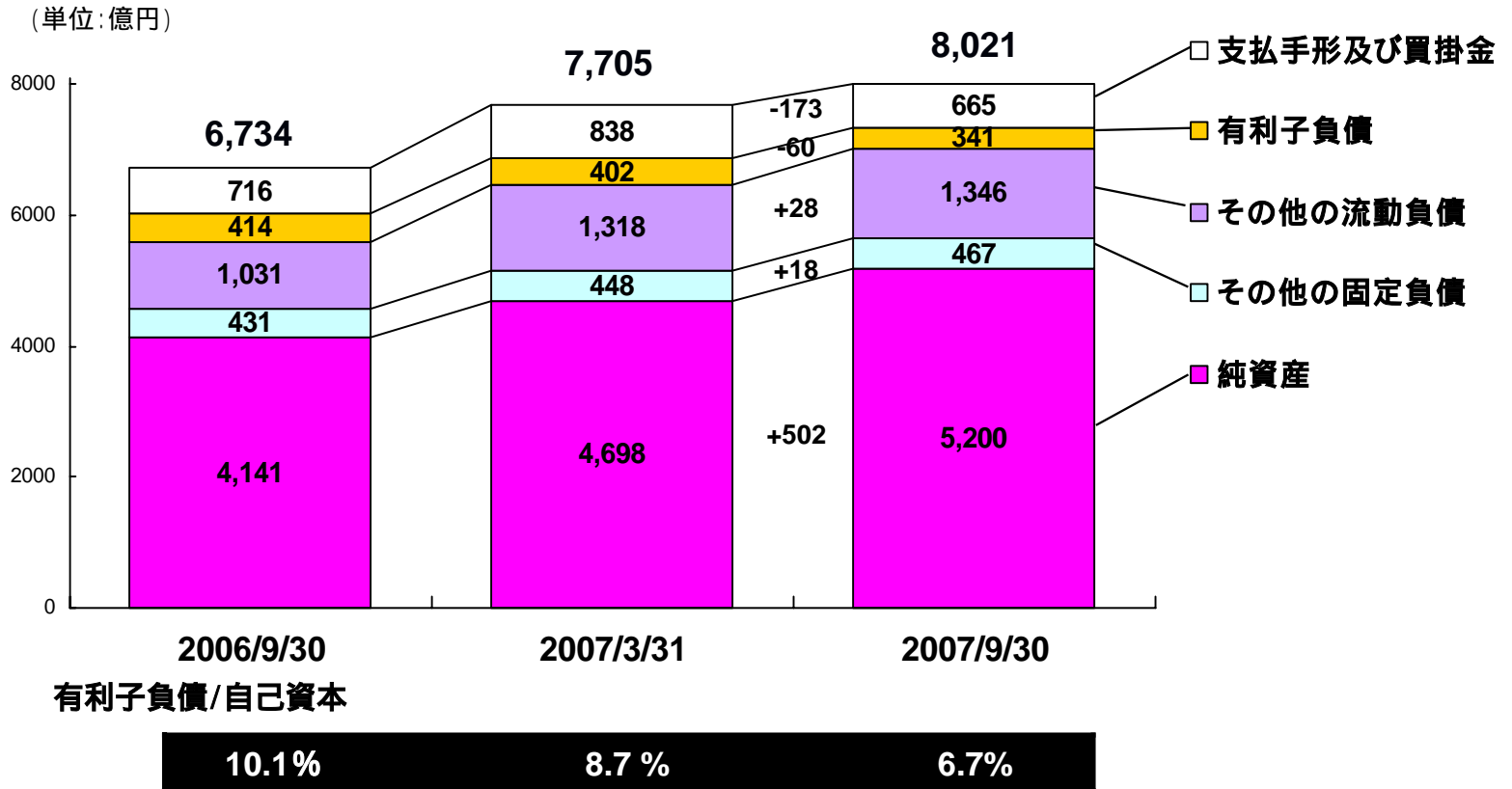


(単位:億円)



2008年3月期 中間決算(連結)

負債・純資産

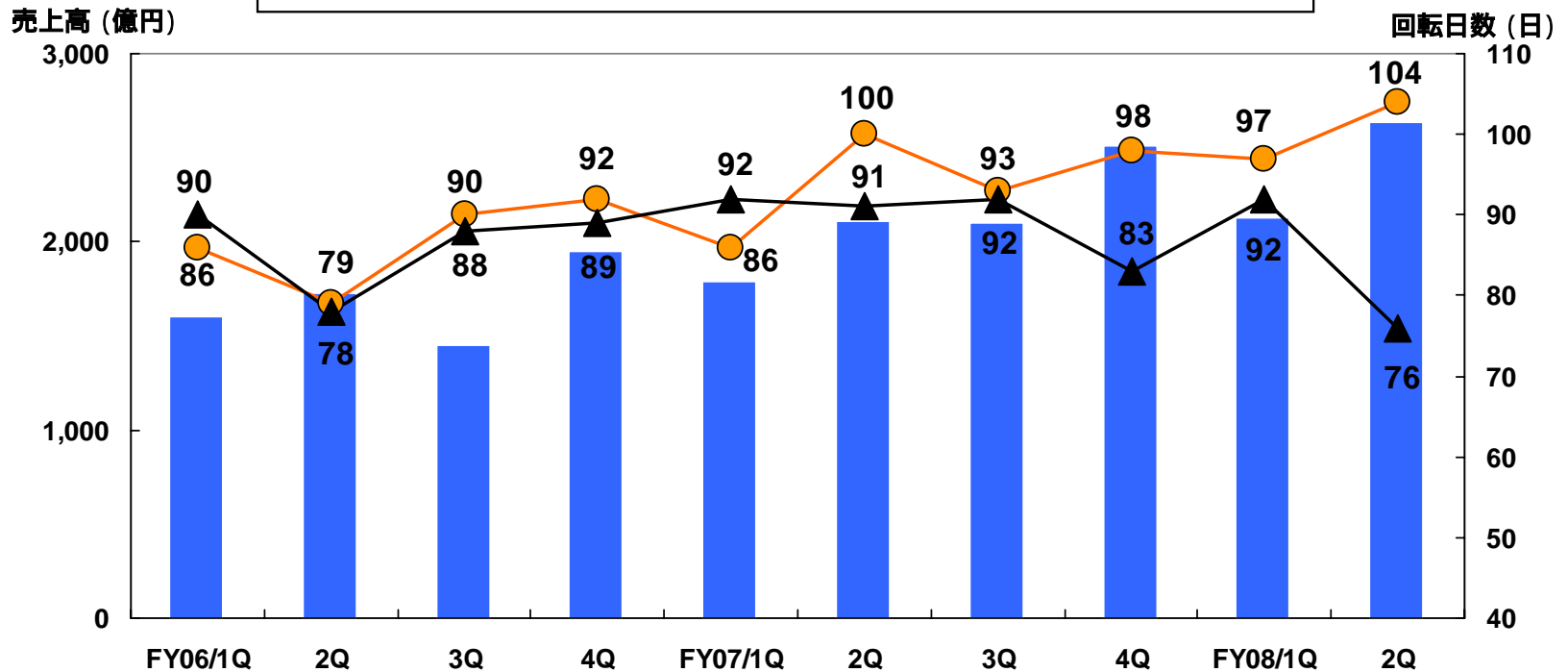


* 自己資本 = 純資産 - (新株予約権 + 少数株主持分)



2008年3月期 中間決算(連結)

たな卸資産・売上債権の回転日数



●回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

●FY2006/1Qの回転日数算出に使用したFY2005/2Q売上高 = 新会計方針によるFY2005/1Hの売上高 ÷ 2



2008年3月期 中間決算(連結) キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	2007/3中間期 6ヵ月	2008/3中間期 6ヵ月	2007/3通期 12ヵ月(ご参考)
営業活動によるキャッシュ・フロー	44	205	542
税前利益	584	982	1,444
減価償却費	88	98	188
売上債権・たな卸資産・仕入債務・前受金	472	▲431	▲851
法人税等の支払額	231	▲441	▲377
その他	76	▲1	140
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲394	▲85	▲252
設備投資等	91	▲82	▲265
その他	302	▲2	12
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲280	▲163	▲347
有利子負債の減少	▲236	▲61	▲249
配当金の支払額	▲53	▲109	▲128
その他	9	6	30
現金及び現金同等物の増加額	▲629	▲44	▲56
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	770	1,299	1,343

フリーキャッシュフロー、120億円プラス(前中間期、50億円マイナス*)

*定期預金への預け入れ、300億円調整後



2008年3月期 中間決算(連結) 事業の種類別セグメント情報

営業利益・営業利益率

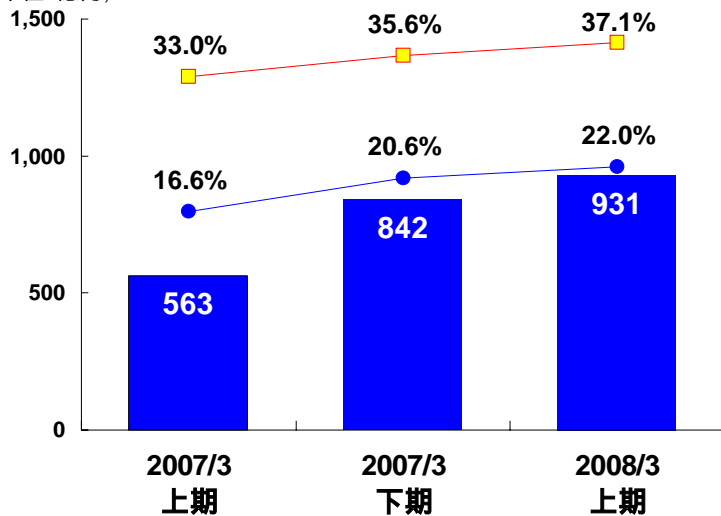
産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、その他)

電子部品・情報通信機器

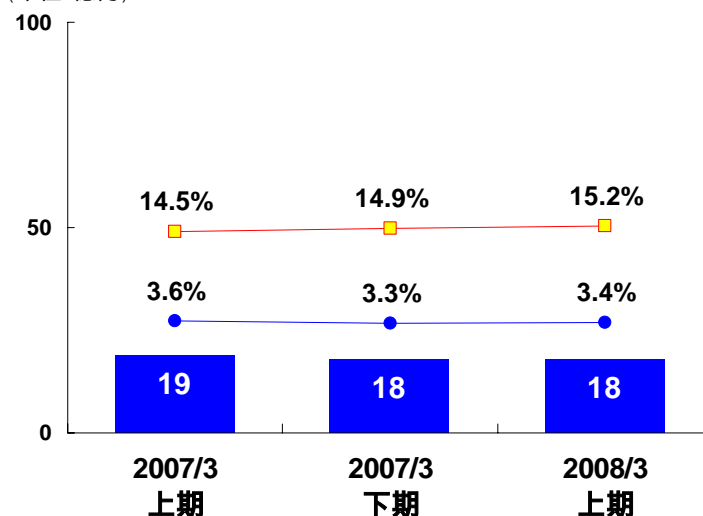
(電子部品、コンピュータ・ネットワーク)

(単位: 億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 □ 売上総利益率

(単位: 億円)



■ 営業利益 ● 営業利益率 □ 売上総利益率

•セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。

•「コンピュータ・ネットワーク」につきましては、2007年3月期下期よりセグメント区分を「電子部品・情報通信機器」に変更しております。2007年3月期上期はセグメント区分を組替えて表記しています。



2008年3月期 中間決算(連結)

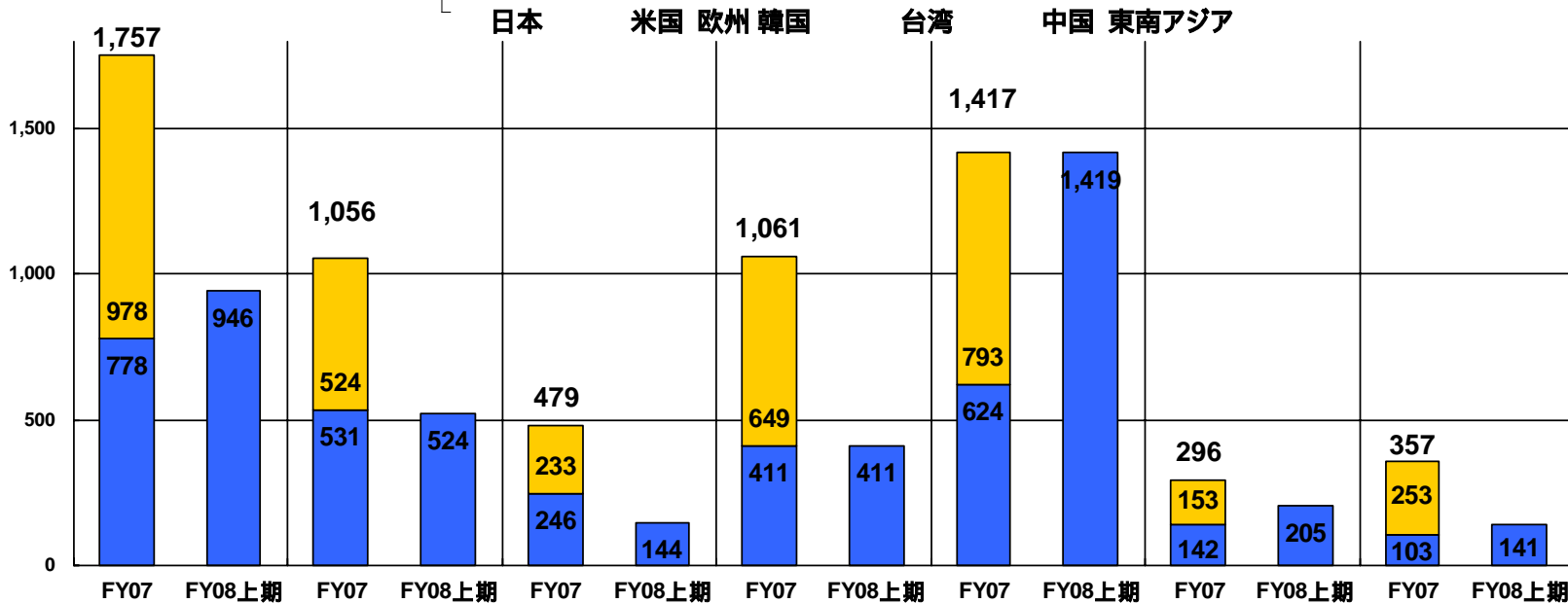
S P E 部門地域別売上高



	日本	米国	欧州	韓国	台湾	中国	東南アジア
2007/3上期	27	19	9	14	22	5	4
2008/3上期	25	14	4	11	37	5	4

2007/3上期 2,839億円
2008/3上期 3,792億円

(単位:億円)



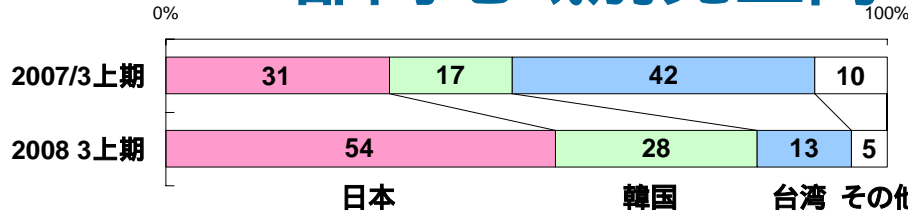
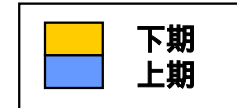
[当上期対前上期]

地域	日本	米国	欧州	韓国	台湾	中国	東南アジア
増減率	22%	-1%	-41%	0%	127%	44%	36%



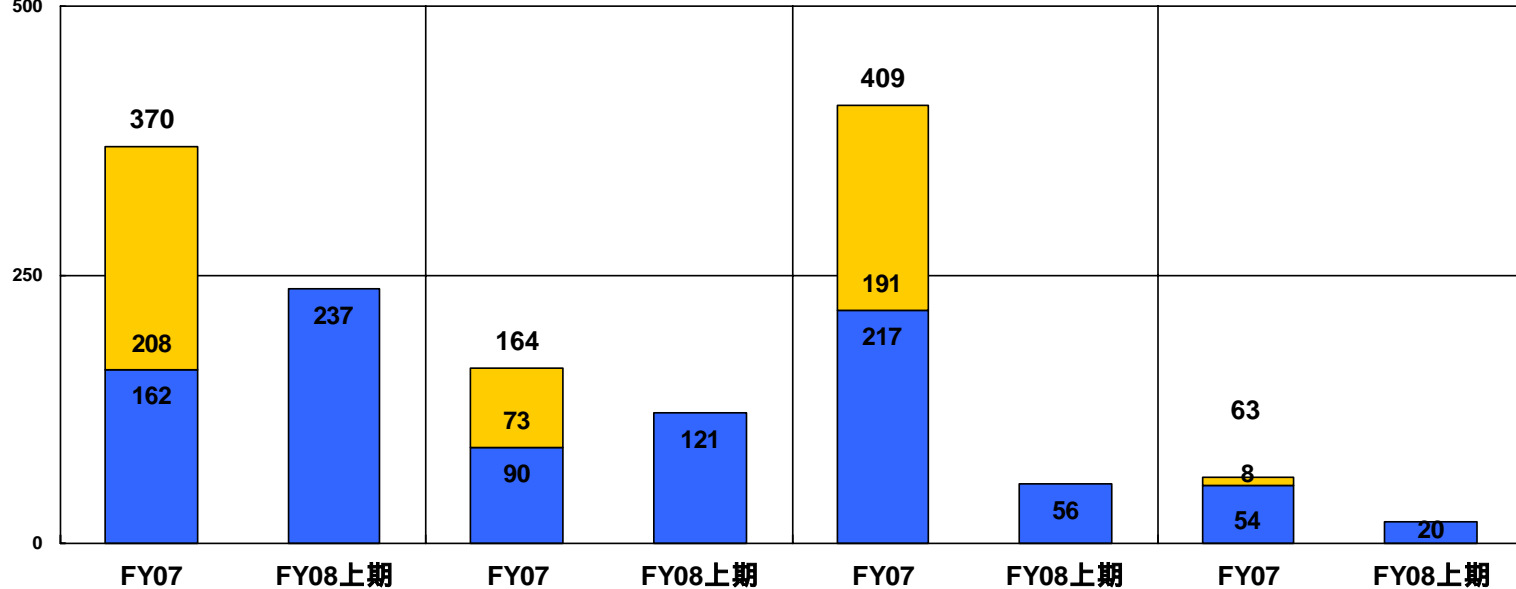
2008年3月期 中間決算(連結)

F P D 部門地域別売上高



2007/3上期 525億円
2008/3上期 436億円

(単位:億円)
500



[当上期対前上期]

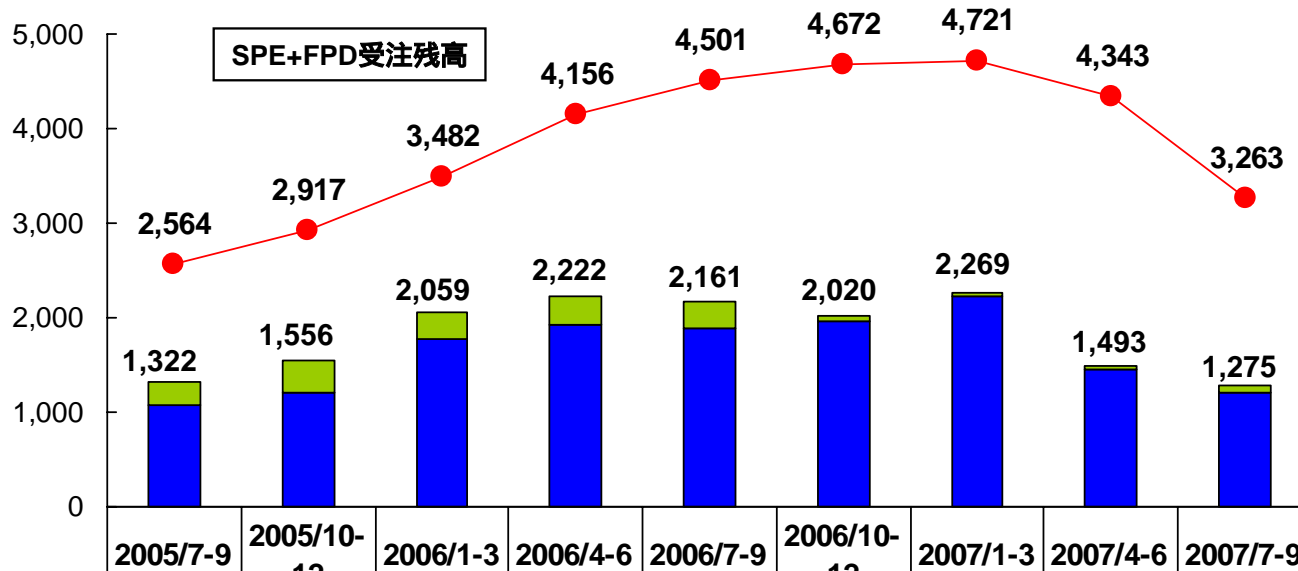
日本	韓国	台湾	その他地域
46%	34%	-74%	-62%



2008年3月期 中間決算(連結)

SPE+FPD受注額, 受注残高

(単位: 億円)



	2005/7-9	2005/10-12	2006/1-3	2006/4-6	2006/7-9	2006/10-12	2007/1-3	2007/4-6	2007/7-9	
FPD製造装置 受注額	240	344	277	296	275	55	42	41	73	
半導体製造装置 受注額	1,081	1,211	1,782	1,926	1,886	1,964	2,227	1,452	1,202	
受注残高	2,564	2,917	3,482	4,156	4,501	4,672	4,721	4,343	3,263	
受注残高内訳	FPD	748	927	990	997	1,036	831	652	479	331
	SPE	1,816	1,990	2,491	3,158	3,464	3,841	4,069	3,864	2,931

●2006年1-3月期より、受注額・受注残高ともに連結ベースに表示変更しています。



四半期決算の推移



2008年3月期 中間決算(連結)

当第2四半期の業績

(単位:億円)

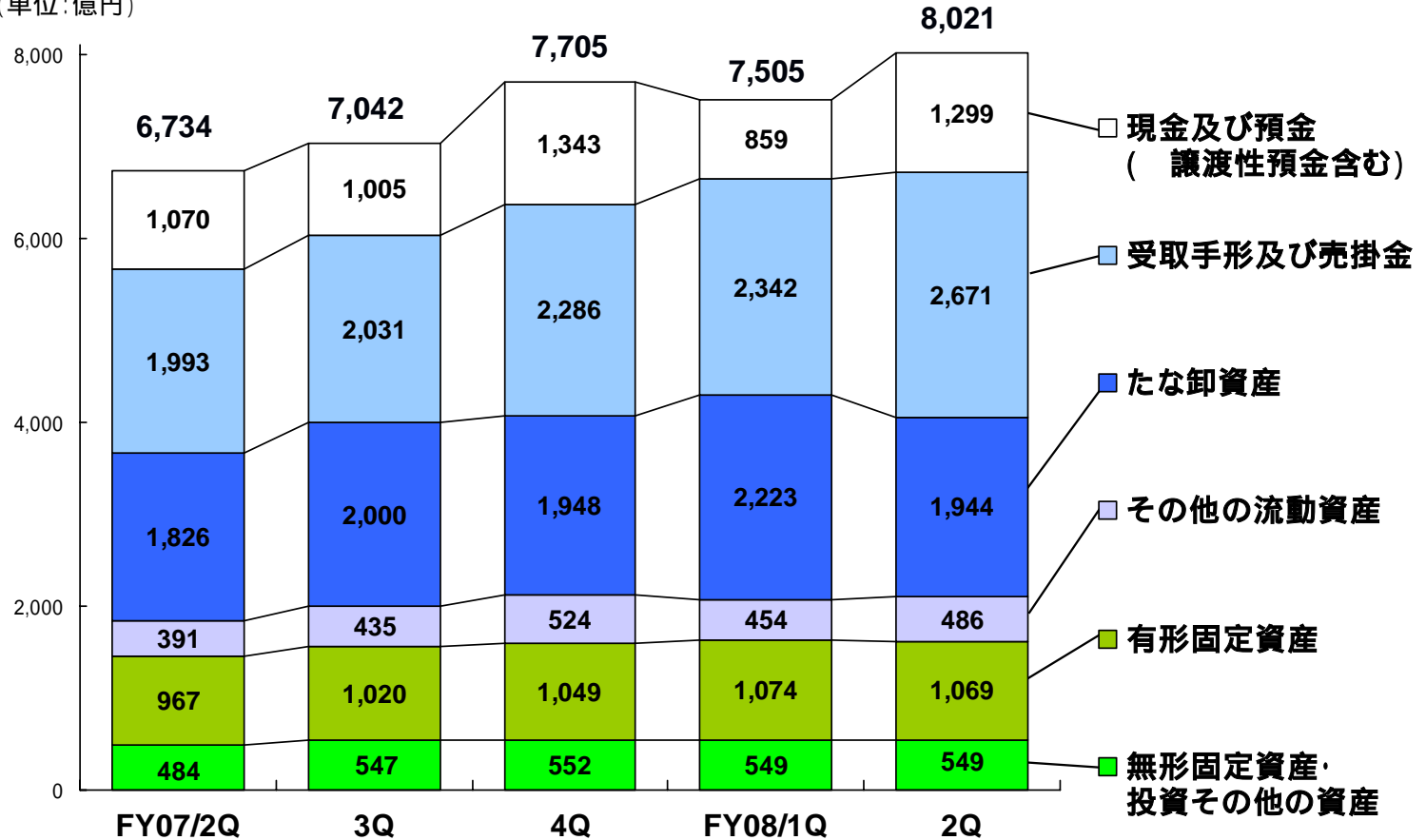
	2007年3月期				2008年3月期			
	3Q		4Q		1Q		2Q	
売上高	2,100		2,513		2,124		2,638	
売上総利益	739	35.2%	793	31.6%	765	36.0%	887	33.6%
販管費	310	14.8%	364	14.6%	335	15.7%	368	13.9%
営業利益	429	20.4%	428	17.0%	430	20.3%	519	19.7%
経常利益	421	20.0%	436	17.4%	411	19.4%	546	20.7%
税前利益	421	20.0%	437	17.4%	424	20.0%	557	21.1%
当期純利益	269	12.8%	270	10.8%	261	12.3%	362	13.7%
研究開発費		133		164		148		170
設備投資額		93		81		70		57
減価償却実施額		48		51		46		51



2008年3月期 中間決算(連結)

資 産

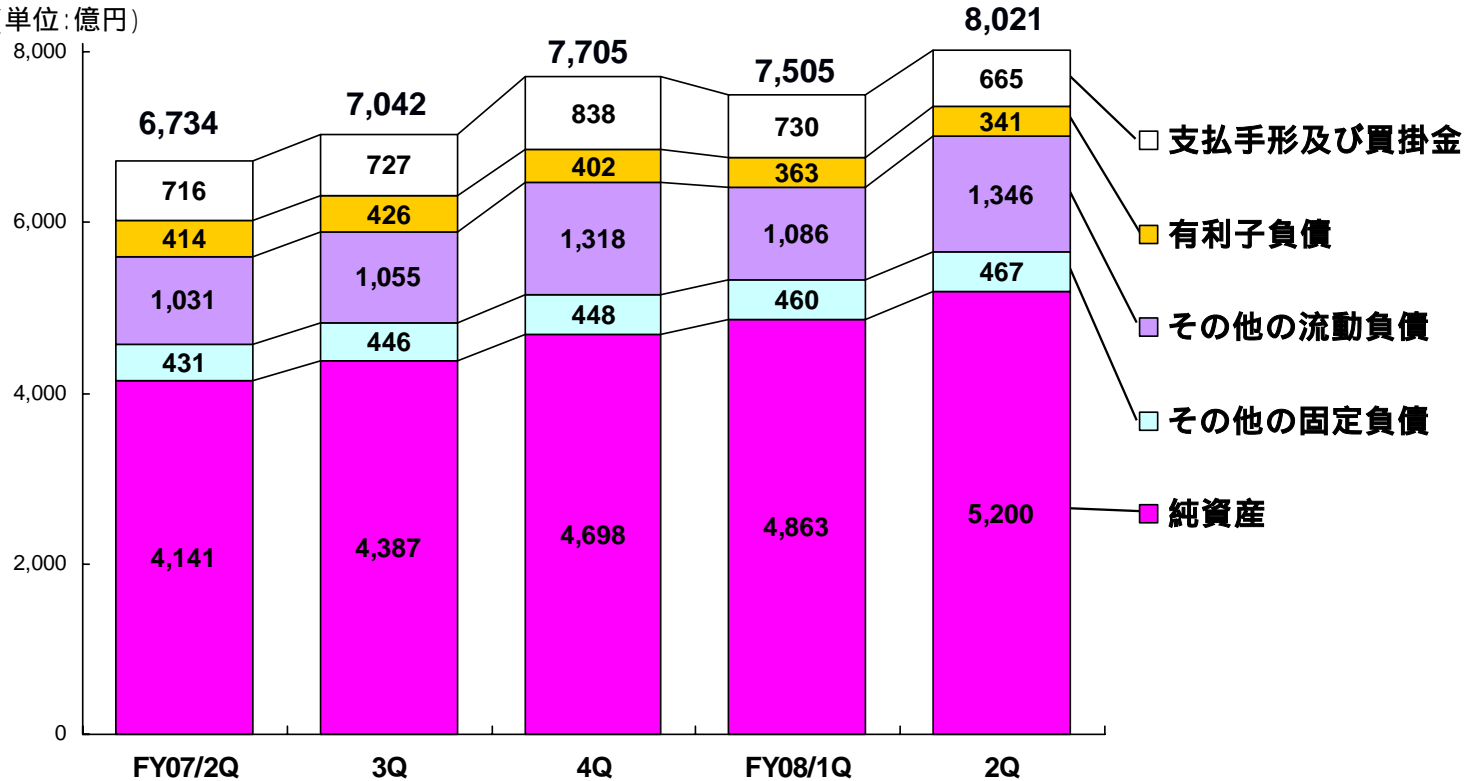
(単位: 億円)



2008年3月期 中間決算(連結)

負債・純資産

(単位:億円)



有利子負債/自己資本

10.1%

9.9%

8.7%

7.6%

6.7%

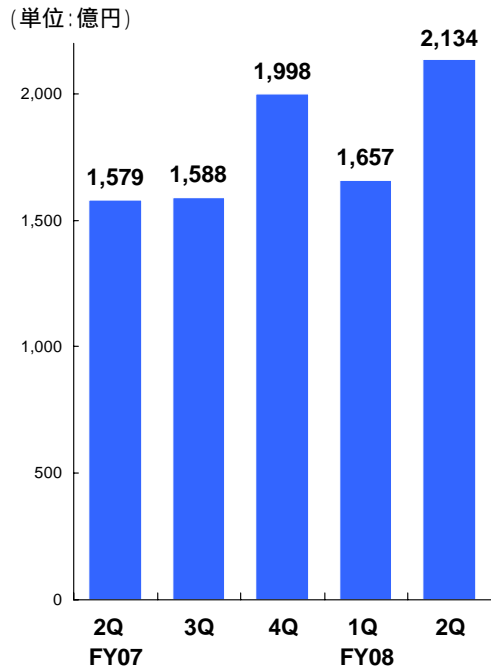
* 自己資本 = 純資産 - (新株予約権+少数株主持分)



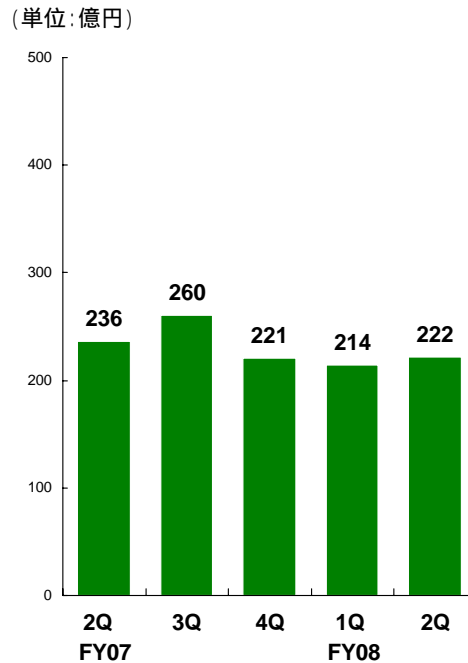
2008年3月期 中間決算(連結)

部門別売上高

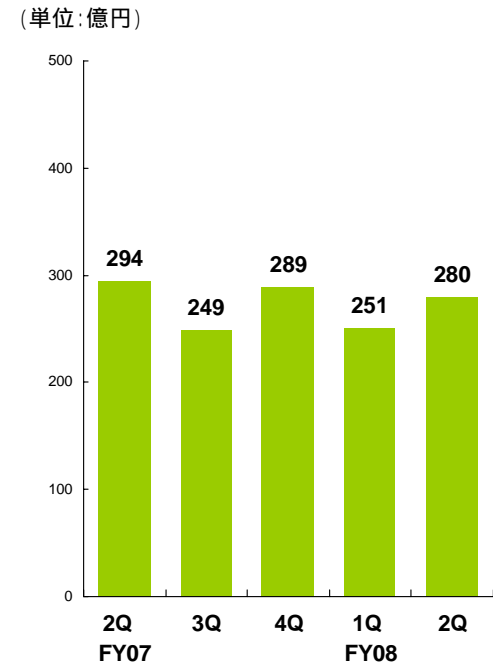
SPE部門 (半導体製造装置)



FPD部門 (フラットパネルディスプレイ製造装置)



EC/CN部門 (電子部品/コンピュータ・ネットワーク)



上記3部門の売上以外に「その他」の売上があります(当2Q売上高1億円)。

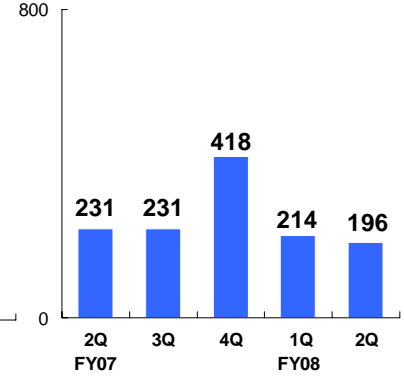
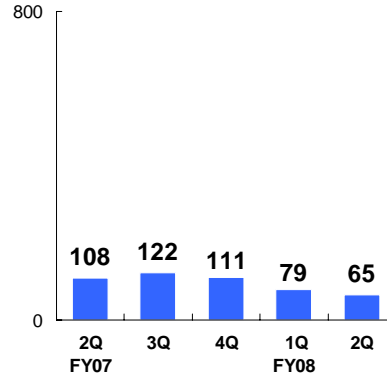
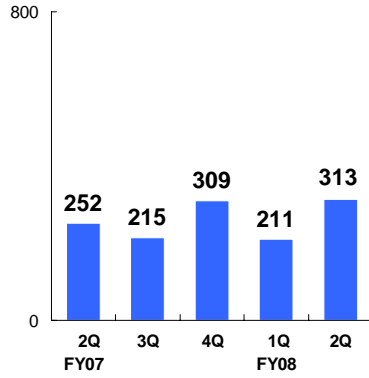
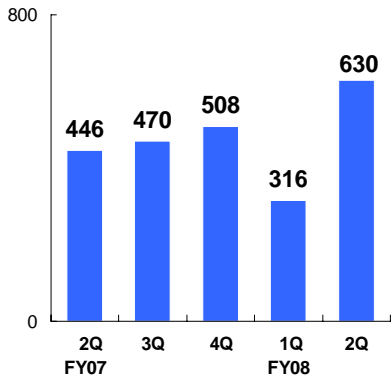


2008年3月期 中間決算(連結)

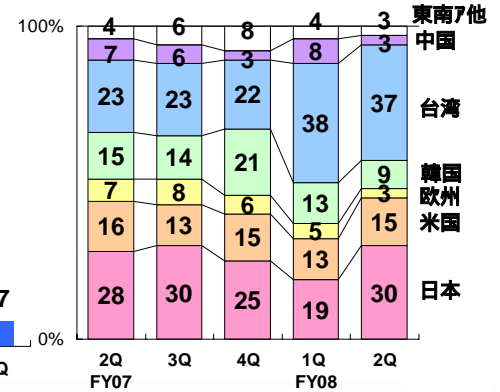
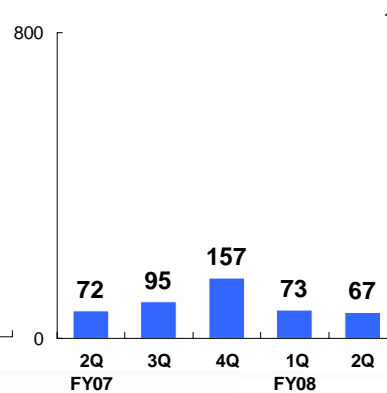
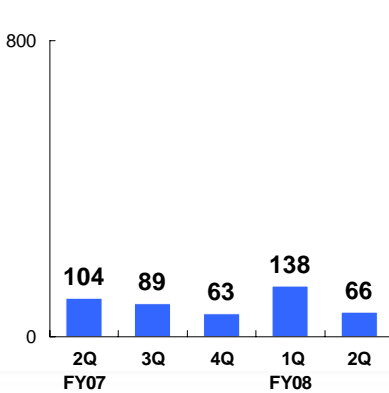
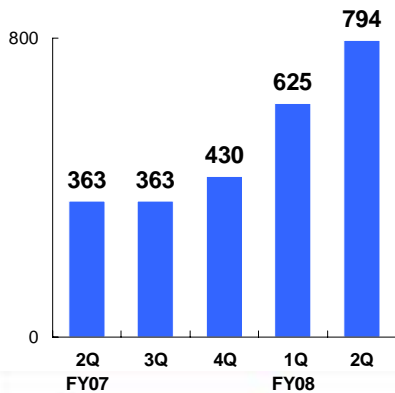
S P E 部門地域別売上高

(単位:億円)

日本 米国 欧州 韓国



台湾 中国 東南アジア他 地域別構成比

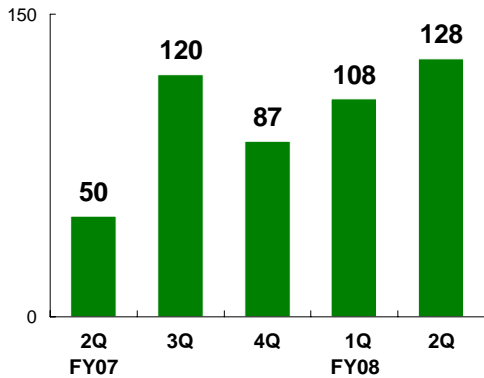


2008年3月期 中間決算(連結)

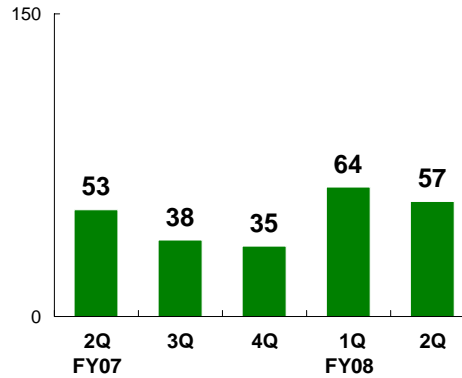
F P D 部門地域別売上高

(単位:億円)

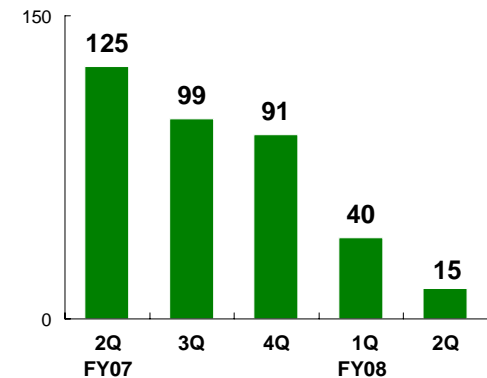
日本



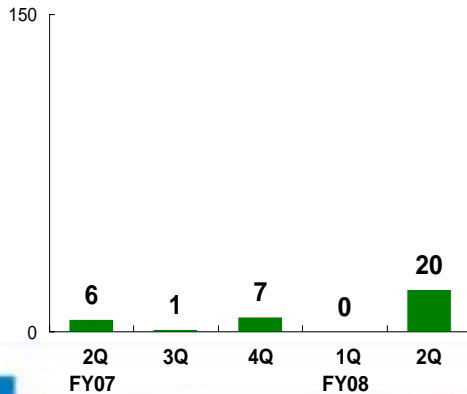
韓国



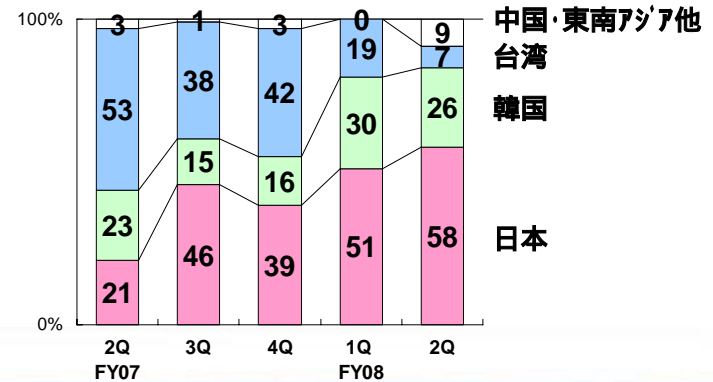
台湾



中国・東南アジア他



地域別構成比



2008年3月期 中間決算(連結)

キャッシュ・フロー

(単位:億円)

	2007年3月期				2008年3月期	
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
営業活動によるキャッシュ・フロー	38	6	133	364	295	500
投資活動によるキャッシュ・フロー	42	351	146	5	46	39
財務活動によるキャッシュ・フロー	93	186	46	19	142	21

現金及び現金同等物の増加額	97	531	235	338	484	439
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

現金及び現金同等物の期末残高	1,302	770	1,005	1,343	859	1,299
----------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------



2008年3月期 中間決算(連結)

事業の種類別セグメント情報

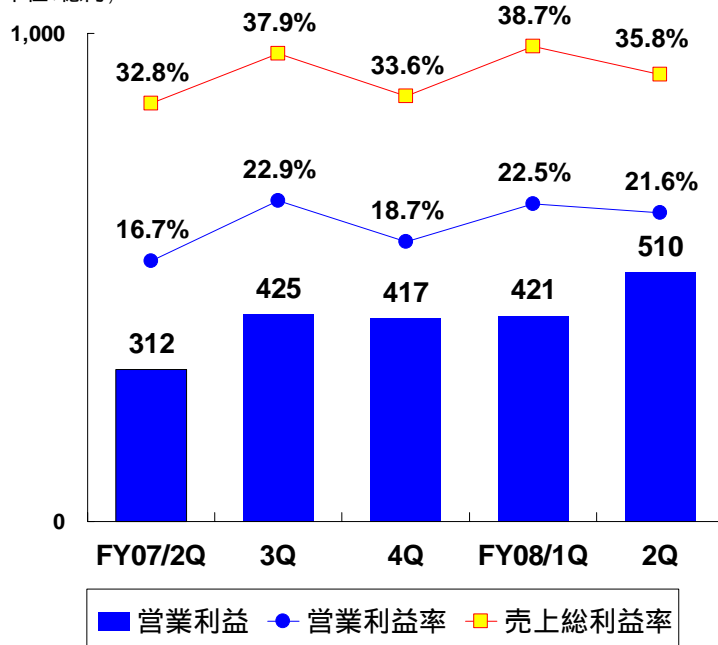
産業用電子機器

(半導体製造装置、FPD製造装置、その他)

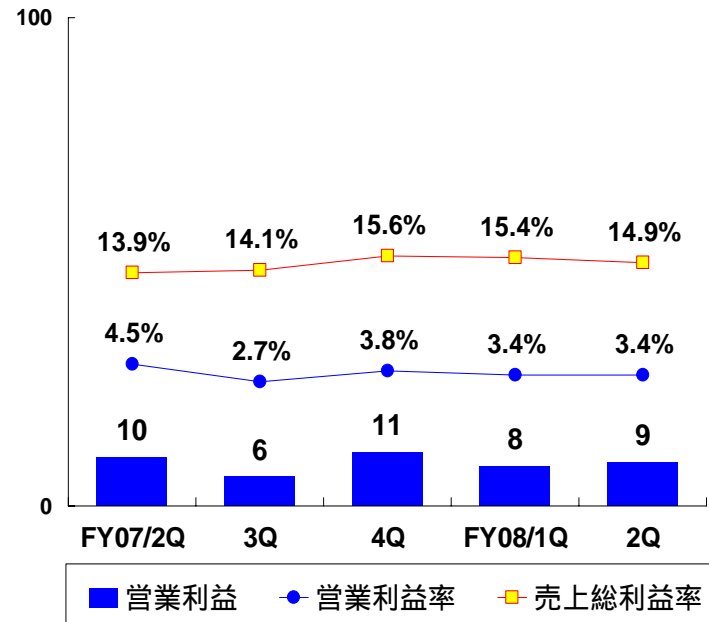
電子部品・情報通信機器

(電子部品、コンピュータ・ネットワーク)

(単位:億円)



(単位:億円)



- セグメントの売上総利益率は、参考として掲載しています。
- 2007年3月期の2Qはセグメント区分の組み替えを行っていません。



